

高温真空加熱装置－1800℃－

■ 用途

真空排気、最高 1800℃の加熱処理を自動運転で行えます。

処理雰囲気は、高真空、アルゴン・水素などの不活性・還元性雰囲気の選択が可能です。

ハロゲンランプ部品の製造、医療用部品などの高温熱処理に活躍しています。

高融点金属・セラミックス等の改質、アニール、エージングなど各種ご要望に応じたカスタマイズをご提案いたします。

【導入分野】量産向け生産、研究開発、試作品開発



■ 特徴

排気、熱処理プロセスを自動で行うことができる縦型真空熱処理装置です。

チャンバ下部のステージにセットした試料は、エレベータによって真空槽内に格納されます。

ヒーターエレメントはタングステン、モリブデンなどから雰囲気に応じて提案します。

ドライな排気系で構成され、清浄な雰囲気で処理が行うことができ、またプロセスに応じた各種ガスを導入することが可能です。

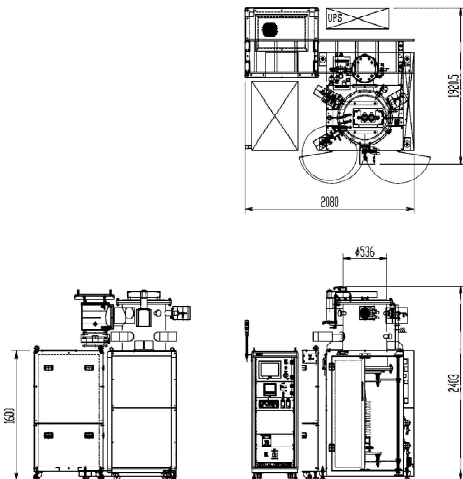
ターボ分子ポンプ、ドライ真空ポンプによる 10^{-5} Pa 台の到達真空圧力を標準仕様とし、クリーンな雰囲気が要求される処理に対応します。

お客様の御要望に沿って、雰囲気、ワークステージ、昇温条件にお応えしています。

■ 仕様

高温真空加熱装置—1800℃—

排気性能	到達圧力	$\leq 1.0 \times 10^{-5}$ Pa	制御系	主操作	制御盤 PLC 操作
	排気時間	$\leq 5.0 \times 10^{-4}$ Pa 60 min 以内		自動動作機能	排気系動作 プロセス運転
真空槽	真空槽	SUS チャンバ (水冷ジャケット式)	オプション	ベントガス (増設、変更)	Ar 他
排気系	主排気ポンプ	ターボ分子ポンプ (水冷)		プロセスガス	O ₂ 、H ₂ 他
	補助ポンプ	ドライ真空ポンプ or 油回転ポンプ	ユーティリティ	電力・接地	主電源系 3φ AC200V 250A 50/60 Hz
	各種バルブ	PLC 操作(自動および手動)		冷却水	供給圧 : 0.2 ~ 0.3 MPa 水温 : 20 ~ 35 °C 水量 : ≥ 60 L/min
真空計	低真空	ピラニ真空計		ベントガス	窒素ガス 0.1 ~ 0.15 MPa
	高真空	電離真空計	圧縮空気	0.5 ~ 0.8 MPa	
槽内アクセス	アクセスポート (天板、下フランジ)	O リングシール	機能	設置面積	(W×D×H) =2150mm×2200mm×3400mm
加熱温度	加熱温度	常用 1600 °C MAX 1800 °C		有効加熱範囲	(φ×H) =φ160mm×450mm
	昇温速度	1600 °C / 60 分 (無負荷)			



■ 株式会社 日本シード研究所

本社・工場： 〒252-1125
神奈川県綾瀬市吉岡東 2-3-27

電話： 0467-77-4351

FAX： 0467-77-9858

URL： <https://www.seed-lab.com>

※外観・仕様については改善のため予告なく変更することがあります。
2024.11